运放差分和单端工作模式的区别

1 概述

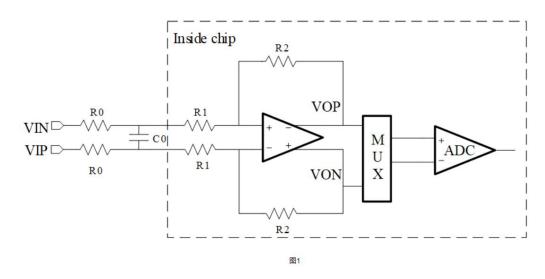
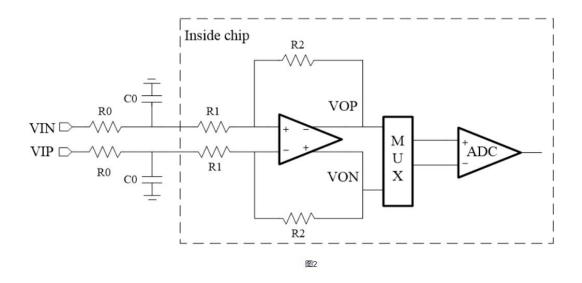


图 1 中两个 RO 是片外需放置的电阻,阻值必须相等,最终的放大倍数为 Gain=R2/(R1+R0),反馈电阻 R2:R1 的阻值可通过寄存器 RES_OPAx[1:0]设置,以实现不同的放大倍数。ADC 的输入信号范围最大为+/-3.6V,因此运放增益设置的原则是使得最大输入信号时,经运放放大后的信号幅度接近+/-3.6V,留一定的冗余度即可。

对于 MOS 管电阻直接采样的应用,由于 MOS 下管关断、上管导通时信号会升 高到数十 V 的电源电压,为减小此时往芯片引脚里流入的电流,一般建议接>20k 欧的外部电阻 RO。

对于康铜丝等取样电阻采样的应用,建议接 100~1K 欧的外部电阻。C0 为信号滤波电容,和 R0 形成一阶 RC 滤波电路。R0 的具体阻值可根据 R0*C0 的滤波常数而定。如果信号上噪声较小不需要滤波、或者信号需要很大的带宽(较快的响应速度),则 C0 可以不加。

如果输入信号 VIP/VIN 之间的共模噪声特别大,则可将 1 个跨接电容 C0 改为 2 个电容到地的电容。如图 2 所示



放大器可通过设置 OPAOUT_EN<2:0>选择将 4 路放大器中某一路的正端输出信号 VOP 通过 BUFFER 送至 P2.7 IO 口进行测量和应用(对应关系见 datasheet 芯片管脚说明)。因为有 BUFFER 存在,在运放正常工作模式下也可以选择将其 VOP 信号出来,此时该运放相当于同时作为差分运放和单端运放使用。

2 差分工作模式

运放输出的差分信号: Vsig = VOP - VON = Gain * Vin +Gain * Voffset 其中: Vin=VIP-VIN; Gain = R2/(R1+R0); Gain * Voffset 为运放经过放大后的零漂,对于应用来说 Gain * Voffset 这项需要剔除。

处理方案:

在芯片上电之初,电机尚未工作时,运放输入信号为 0V,此时通过 ADC 对该路运放进行采样,采到的值就是 Gain * Voffset,软件上将其保存下来,之后读到的该路运放的采样值,都减掉保存的运放零漂。

使用到的每一路运放,都需要保存其相应的零漂值

运放输出信号送给 ADC 采样的方式,是属于差分工作模式。差分工作模式的 优点是精度高、抗干扰能力强,这也是运放的正常工作模式。

3 单端工作模式

除差分模式之外,运放还有两种单端应用模式:

- 1) 将某路运放的正输出端 VOP,通过设置 CMPx_SELP<2:0>(x=0/1)送至比较器 0/1 的正输入端,比较器的负输入端通过设置 CMPx_SELN<1:0>(x=0/1)连至 DAC 模块的输出,这种应用方式,可将放大后的信号做过流保护使用。
- 2) 通过设置 OPAOUT_EN<2:0>将 4 路放大器中某一路的正端输出信号(VOP) 通过 BUFFER 送至 P2.7 IO 口,控制芯片外部的某些模块,或者将该信号在芯片外做滤波后得到信号平均值,重新送到芯片的另一个 ADC 输 入通道管脚,由 ADC 去测量滤波后的信号。

这两种应用方式由于都只利用了运放输出正端信号 VOP,属于将差分运放作为单端运放应用。单个运放可以同时作为差分运放和单端运放来使用,即运放输出信号被 ADC 采样的同时,将正端输出 VOP 连至比较器,或送至 P2.7 IO 口使用。

VOP/VON 的信号公式为:

VOP = Vcm + Vsig/2

VON = Vcm - Vsig/2

其中, Vcm 是运放输出的共模电压, 一般为 1.9V, Vsig 为运放输入信号经放大后的差分信号。假设某个输入信号下, 放大后的 Vsig=2V, 则 VOP 为 2.9V, VON 为 0.9V。

可以看出,对于差分应用模式,Vcm的值没有影响。但是对于单端应用模式,Vcm的作用则不可忽视。

3.1 单端模式 Vcm 的校正

对于不同芯片运放的 Vcm, 有离散性, 大批量时, 相比于 1.9V 的平均值, 最大偏差可能达到一百多毫伏。因此有必要对 Vcm 做校正。

校正方式:

在芯片上电之初,电机未运行时,运放输入信号为 0V,此时将作为单端模式应用的那路运放 VOP 通过配置 OPAOUT_EN<2:0>送至 P2.7 IO 口, P2.7 IO 口是 ADC_CH11, 用 ADC 对 CH11 进行采样,采样得到的值即为 Vcm 对应的 ADC 值。实际的物理值(即多少 V)则可根据 ADC 值计算得到。

如果 P2.7 IO 口在 PCB 上有阻容滤波,如图 3 所示:

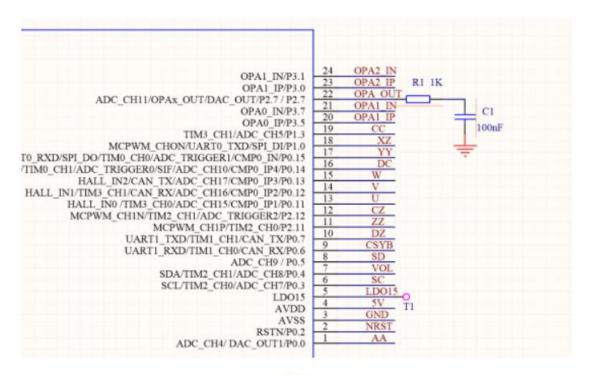


图 3

则将运放 VOP 信号送出后,P2.7 的信号要经过一段时间才能达到稳定,稳定时间的计算公式为: T = 6 * (1000 + R) * C。

以图 3 中 R1=1k, C1=100n 来计算,需等待的时间为 1.2ms。如果片外没有电阻 R1,则取 R=0 即可。需留意的是,VOP 信号送至 P2.7 IO 口的话,由于 VOP Buffer 的电流驱动能力有限,该 IO 口对地的阻抗需要大于 40k。图 3 中的电阻 R1,因为后面对地还有电容 C1,因此对地阻抗满足要求。

上电之初 ADC 采集到的 Vcm 在软件上保存下来,对于上述两种单端应用模式:

1) VOP 送至比较器的正输入端, DAC 信号送至比较器负输入端:

对于要做保护的阈值 VHsig(即运放放大后的信号 Vsig 超过 VHsig 后比较器应翻转), VOP 的信号是 Vcm+VHsig/2, 因此连至比较器负端的 DAC 值应设置为 Vcm+VHsig/2,其中 Vcm 采用上面软件保存的值所对应的物理值,物理值和 ADC 值之间的换算参看 user manual 的 ADC 章节。

2) VOP 送至 P2.7 IO 口,控制芯片外的模块,或者将该信号在芯片外做滤波后得到信号平均值,重新送到芯片的另一个 ADC 输入通道管脚,由 ADC 去测量滤波后的信号: ADC 采集到的做过滤波的 VOP 信号值,都需要减掉软件保存的 Vcm,得到的是 Vsig/2,即运放输出信号的一半大小。

3.2 单端模式 Vcm 随温度的变化

上述部分校正了不同芯片之间运放共模电平 Vcm 的差异,但 Vcm 随温度还有约-0.5mV/℃的变化。即 125 度相比 25 度, Vcm 将下降 50mV。如果应用上要求精度较高,则有必要修正 Vcm 的温度变化量。

校正方式:

在芯片上电之初,将运放 VOP 送至 P2.7 IO 口进行 ADC 测量得到 Vcm0 的同时,测量芯片内部温度传感器的温度(详见 usermanual 温度传感器章节)TO。后面电机运行过程中,每隔几秒或者 1 分钟,测量一次温度值 T1,计算温度差 VT = T1 - T0。此时的运放共模电压 Vcm = Vcm0 + VT * (-0.5m)。

对于上述两种单端应用模式,应采用随温度更新过的 Vcm:

1) VOP 送至比较器的正输入端, DAC 信号送至比较器负输入端:

对于要做保护的阈值 VHsig(即运放放大后的信号 Vsig 超过 VHsig 后比较器应翻转), VOP 的信号是 Vcm+VHsig/2, 因此连至比较器负端的 DAC 值应设置为 Vcm+VHsig/2,其中 Vcm 采用上面软件保存的值所对应的物理值,物理值和 ADC 值之间的换算参看 user manual 的 ADC 章节。

2) VOP 送至 P2.7 IO 口,控制芯片外的模块,或者将该信号在芯片外做滤波后得到信号平均值,重新送到芯片的另一个 ADC 输入通道管脚,由 ADC 去测量滤波后的信号: ADC 采集到的做过滤波的 VOP 信号值,都需要减掉软件保存的 Vcm,得到的是 Vsig/2,即运放输出信号的一半大小。

但即使做过温度修正,运放单端模式的精度仍然不如差分模式,对于需要精确测量小电流信号的场合,建议还是使用单独一个运放的差分模式。